

## 導熱灌封膠 SSTCA-006

### Thermally Conductive Adhesive

SSTCA系列導熱灌封膠是具有優異的導熱效能、熱膨脹率低、完全絕緣不導電，有效地消除電子元件因工作溫度變化產生的破壞作用，並且可在室溫或加溫下固化，在固化前SSTCA系列有優良的流動性；固化後也不會因為冷熱交替使用而從保護外殼脫出，其灌封表面光滑並無揮發物生成。本產品的固化後擁有優良的抗毒性，在一般情況下無須對焊錫及塗料等作特殊處理，並廣泛運用於黏合發熱的電子產品和散熱片或金屬外殼。

#### 產品特性

- 應力低，更為有效的保護電器元件。
- 100%固態，固化後無滲出物。
- 優越的耐高低溫性，極好的耐氣候、耐輻射及優越的介電性能。
- 優越的化學和機械穩定性。
- 室溫或加溫固化。
- 良好的黏著性。
- 高導熱、高絕緣。

#### 產品應用端

- 功率模組、電源模組。
- 電子產品。
- 控制器。
- PC及其週邊設備灌注使用。
- LED組裝。
- 電訊設備。



#### SSTCA-006 導熱灌封膠規格表

Properties	Methods	SSTCA-006	Unit
顏色	目測	A -Gray,B-White	-
A/B 混合比例	-	1 : 1	-
粘度	Brookfield HB 502@10~30rpm	6000~8000	cps
操作期(小時,25°C)	*2	1.5	hr
導熱率	ASTM D5470 Modified *1	0.65	W/mk
室溫固化時間(25°C)	*2	4	hr
加熱固化時(80°C)	*2	10	minute
密度	ASTM D792	2.00	g/cm <sup>3</sup>
延伸率	JIS K6251	550	%
絕緣破壞強度	ASTM D149	>9	KV/mm
體積電阻	ASTM D257	≥3x10 <sup>14</sup>	Ω · cm
保存期限	-	12個月	month
耐燃等級(0.3mm)	UL 94	V-0	UL No. E352845
連續使用溫度	-	- 40~+150°C	-
固化後硬度	ASTM D2240	50~70	Shore00

註記:符合RoHS規範. Testing sample thickness:1.0mm.

\*1: Thermal conductivity test thickness is 1/2/3T according to ASTM D5470 and tested with LW-9389 machine. Tolerance is ± 10%.

\*2: Development test capacity: 100~200g.

#### 使用說明:

1. 注意容器是否清潔。取A/B劑 均勻混和。
2. 灌注至容器後，靜置約1小時，再進行固化(此靜置動作請特別注意)。
3. 攪拌均勻後用顏色判斷均勻無色差後，抽真空脫泡10分鐘。(此舉主要消除微小氣泡，氣泡於矽膠裡會造成破裂點延伸，如有真空點膠機此舉可省略)。
4. 本產品屬附加反應硬化型，若有N(氮),P(磷),S(硫)有機化合物或重金屬離子的化合物混入，會造成硬化不良。

\*These data are provided for reference only. Engineers are reminded to test the material in varied application.